

导电性粘结剂

各类电子部件用

为微电子领域开发的高性能导电性粘合剂。电子部件内有无耐热性的材料，在不能使用焊料的情况下，作为代替焊料的导电粘合和印刷电路板（PCB/PWB）上搭载电子部件等，可以广泛用于焊接、溶接的课题解决。产品阵容以导电性、粘接强度、耐热性、柔软性、操作性等为特征，配合用途和加工方法，产品在溶剂型/无溶剂型、固化条件、粘度等方面具有丰富多彩的选择。

特性

品名	导电性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	粘接强度 (N/mm^2)	热分解温度 ($^{\circ}\text{C}$) ※ 1	杨氏模量 (GPa) ※ 2	固化条件	保存条件	稀释剂	可适用加工方法	特长
FA-705BN	6×10^{-4}	8	250	5	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min	冷藏	无溶剂	丝网印刷 点胶	广泛的适用用途 接触电阻特性良好
XA-874	8×10^{-5}	20	350	4	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min	冷冻	无溶剂	丝网印刷 点胶	高耐热性 高强度 有丰富的车载用实际业绩
XA-910	4×10^{-4}	20	350	7	100 $^{\circ}\text{C}$ 60min 150 $^{\circ}\text{C}$ 30min 180 $^{\circ}\text{C}$ 7min	冷冻	无溶剂	丝网印刷 点胶	低温固化性 高耐热性
XA-5617	4×10^{-3}	15	340	3	200 $^{\circ}\text{C}$ 10min 180 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷冻	无溶剂	MetalMask 网板印刷 ※另外也设计有点胶对应产品	适用于锡电极
XA-5905	4×10^{-4}	45	360	5	150 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷冻	无溶剂	转印 点胶 丝网印刷	高耐热性 高强度

AA55	0.8×10^{-4}	6	260	6	100°C 30min	A 液: 冷藏 B 液: 冷藏	SH 稀释剂	转印点胶	双组分低温固化性
------	----------------------	---	-----	---	-------------	--------------------	--------	------	----------

※1 TGA 法测定 1%减量温度 in Air

※2 DMS 法测定

上述系列产品均符合欧洲 RoHS 指令。

上述数值均为代表值，并非规格值。

储存: 该产品应在 0~35℃避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全: 对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。